



艾凯咨询
ICAN Consulting

2011-2015年中国IC先进封装 产业链发展市场分析与投资前景 预测报告

一、调研说明

《2011-2015年中国IC先进封装产业链发展市场分析与投资前景预测报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/188795.html>

报告价格：纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话：400-700-0142 010-80392465

电子邮箱：sales@icandata.com

联系人：刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、摘要、目录、图表

IC先进封装主要指IC载板封装,主要包括BGA、CSP、FC、LGA型封装,应用领域主要包括手机、内存、PC、网络通信、消费类电子等诸多领域。先进封装技术由于其更小的面积、更低的成本,未来必将对传统封装进行全面的替代。先进封装的增长潜力远远高于传统封装行业,是全球各大封装未来发展的主要方向。

艾凯数据研究中心发布的《2011-2015年中国IC先进封装产业链发展市场分析与投资前景预测报告》共十八章。首先介绍了中国IC先进封装行业的概念,接着分析了中国IC先进封装行业发展环境,然后对中国IC先进封装行业市场运行态势进行了重点分析,最后分析了中国IC先进封装行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国IC先进封装行业有个系统的了解或者想投资该行业,本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

第一章 IC封装产业相关概述

第一节 IC封装涵盖

第二节 IC封装类型阐述

第三节 明日之星——TSV封装

第二章 2011年世界IC封装产业运行态势分析

第一节 2011年世界IC封装业运行环境浅析

第二节 2011年世界IC封装运行现状综述分析

第三节 2011年世界IC封装重点企业运行分析

第四节 2011-2015年世界IC封装业趋势探析

第三章 2011年中国IC封装行业市场运行环境解析

第一节 2011年中国宏观经济环境分析

第二节 2011年中国IC封装市场政策环境分析

第三节 2011年中国IC封装市场技术环境分析

第四章 2011年中国IC封装产业整体运行新形势透析

第一节 2011年中国IC封装产业动态聚焦

第二节 2011年中国IC封装产业现状综述

- 第三节 2011年中国IC封装产业差距分析
- 第四节 2011年中国IC封装产思考
- 第五章 2011年中国IC封装技术研究
 - 第一节 2011年中国IC封装技术热点聚焦
 - 第二节 高端IC封装技术
- 第六章 2011年中国高端IC-3D封装市场探析（3D-IC封装）
 - 第一节 3D集成系统分析
 - 第二节 2011年中国高端IC-3D封装发展总况
 - 第三节 高端IC-3D封装研究进展
 - 第四节 3D-IC集成封装系统（SiP）的可行性研究
- 第七章 2011年中国IC封装测试领域深度剖析
 - 第一节 2011年中国IC封装测试业运行总况
 - 第二节 新型封装测试技术
- 第八章 2007-2011年中国集成电路制造行业数据监测分析
 - 第一节 2007-2011年中国集成电路制造行业规模分析
 - 第二节 2011年一季度中国集成电路制造行业结构分析
 - 第三节 2007-2011年中国集成电路制造行业产值分析
 - 第四节 2007-2011年中国集成电路制造行业成本费用分析
 - 第五节 2007-2011年中国集成电路制造行业盈利能力分析
- 第九章 2011年中国IC封装产业运行新形势透析
 - 第一节 2011年中国IC封装产业运行综述
 - 第二节 2011年中国IC封装产业变局分析
 - 第三节 金融危机对中国IC封装业影响及应对分析
 - 第四节 2011年中国IC封装业面临的挑战分析
 - 第五节 对发展我国IC封装业的思考
- 第十章 2011年中国IC封装细分市场运行分析
 - 第一节 手机IC封装市场
 - 第二节 手机基频封装
 - 第三节 智能手机处理器产业与封装
 - 第四节 手机射频IC
 - 第五节 PC领域先进封装
- 第十一章 2011年中国封装用材料运行分析

第一节 金线

第二节 IC载板

第十二章 2011年中国分立器件的封装发展透析

第一节 半导体产业中有两大分支

第二节 分立器件的封装及其主流类型

第三节 2011年中国分立器件的封装现状综述

第十三章 2011年中国IC封装产业竞争新格局探析

第一节 2011年中国IC封装竞争总况

第二节 2011年中国IC封装产业集中度分析

第三节 2011-2015年中国IC封装竞争趋势分析

第十四章 2011年中国半导体（集成电路）封装重点企业运营财务状况分析

第一节 长电科技（600584）

第二节 深圳赛意法微电子有限公司

第三节 南通富士通微电子股份有限公司

第四节 中芯国际集成电路制造（天津）有限公司

第五节 英特尔产品（成都）有限公司

第六节 无锡菱光科技有限公司

第七节 恒宝股份有限公司

第八节 南京汉德森科技股份有限公司

第九节 深圳市比亚迪微电子有限公司

第十节 常州市欧密格电子科技有限公司

第十五章 2011年中国芯片封装重点企业关键性财务指标分析

第一节 安靠封装测试（上海）有限公司

第二节 沛顿科技（深圳）有限公司

第三节 淄博凯胜电子技术有限公司

第四节 河南鼎润科技实业有限公司

第五节 盟事达智能卡技术（深圳）有限公司

第十六章 2011年中国封装材料企业运营竞争性指标分析

第一节 汉高华威电子有限公司

第二节 厦门惠利泰化工有限公司

第三节 福建易而美光电材料有限公司

第四节 无锡创达电子有限公司

第五节 鼎贞（厦门）系统集成有限公司
第六节 无锡市江达精细化工有限公司
第七节 陕西华电材料总公司
第八节 无锡嘉联电子材料有限公司
第十七章 2011-2015年中国IC封装业前景预测分析
第一节 2011-2015年中国IC封装业前景预测
第二节 2011-2015年中国IC封装产业新趋势探析
第三节 2011-2015年中国IC封装市场前景预测
第四节 2011-2015年中国IC封装市场盈利预测
第十八章 2011-2015年中国IC封装业投资价值研究
第一节 2011年中国IC封装产业投资概况
第二节 2011-2015年中国IC封装投资机会分析
第三节 2011-2015年中国IC封装投资风险预警
第四节 专家投资观点

图表目录

图表 1 全球各国（地区）IC市场占有率
图表 2 全球IC载板市场规模与历年增长率（单位：百万美元）
图表 3 2006年全球IC载板产品类别
图表 4 世界主要有机IC封装基板的大型生产厂家
图表：2006-2011年国内生产总值
图表：2006-2011年居民消费价格涨跌幅度
图表：2011年居民消费价格比上年涨跌幅度（%）
图表：2006-2011年年末国家外汇储备
图表：2006-2011年财政收入
图表：2006-2011年全社会固定资产投资
图表：2011年分行业城镇固定资产投资及其增长速度（亿元）
图表：2011年固定资产投资新增主要生产能力
图表：2011年房地产开发和销售主要指标完成情况
图表21 IC封装的管理标准IPC/JEDECJ-STD-033B.1
图表 22 中国集成电路各产业链产值比重
图表 23 中国IC封装测试业厂商竞争格局

- 图表24 键合前单晶圆上的对准标记
- 图表25 3D-IC集成
- 图表26 晶圆设计规则发展趋势
- 图表27 3D-IC集成SiP示意图
- 图表28 中间层中的IPD示意图
- 图表29 中间层版图
- 图表30 热/机械和电测试芯片
- 图表31 带有热、机械和电测试芯片的中间层
- 图表32 有机BT树脂衬底的顶部和底部（内部）版图
- 图表33 支撑3DICSiP的PCB的版图
- 图表34 用于电、热和机械测量的PCB版图
- 图表35 切割后的PCB
- 图表36 S11、S22和S12的3D-ICTSV测试装置
- 图表37 使用各种热源的最高结温与芯片堆叠数量之间的关系
- 图表38 测量300mm晶圆上3D-ICSiP的TSV热特性的测试装置（背部研磨之前）
- 图表39 存储芯片堆叠中Cu填充TSV的3D非线性热应力分析
- 图表40 (a) 位于TSV中部的SiO₂；(b) Ta势垒层；(c) Cu填充TSV
- 图表41 2007-2011年我国集成电路制造行业企业数量增长趋势图
- 图表42 2007-2011年我国集成电路制造行业亏损企业数量增长趋势图
- 图表43 2007-2011年我国集成电路制造行业从业人数增长趋势图
- 图表44 2007-2011年我国集成电路制造行业资产规模增长趋势图
- 图表45 2011年一季度我国集成电路制造行业不同类型企业数量分布图
- 图表46 2011年一季度我国集成电路制造行业不同所有制企业数量分布图
- 图表47 2011年一季度我国集成电路制造行业不同类型企业销售收入分布图
- 图表48 2011年一季度我国集成电路制造行业不同所有制企业销售收入分布图
- 图表49 2007-2011年我国集成电路制造行业产成品增长趋势图
- 图表50 2007-2011年我国集成电路制造行业工业销售产值增长趋势图
- 图表51 2007-2011年我国集成电路制造行业出口交货值增长趋势图
- 图表52 2007-2011年我国集成电路制造行业销售成本增长趋势图
- 图表53 2007-2011年我国集成电路制造行业费用使用统计图
- 图表54 2007-2011年我国集成电路制造行业主要盈利指标统计图
- 图表55 2007-2011年我国集成电路制造行业主要盈利指标增长趋势图

图表56 2010年手机射频相关公司收入统计

图表57 封装尺寸比较

图表58 尺寸与热特性对比

图表59 部分功率器件封装尺寸

图表60 江苏长电科技股份有限公司主要经济指标

图表 61 江苏长电科技股份有限公司盈利指标走势图

图表 62 江苏长电科技股份有限公司偿债指标走势图

图表 63 江苏长电科技股份有限公司运营指标走势图

图表 64 江苏长电科技股份有限公司成长指标走势图

图表65 深圳赛意法微电子有限公司主要经济指标走势图

图表66 深圳赛意法微电子有限公司经营收入走势图

图表67 深圳赛意法微电子有限公司盈利指标走势图

图表68 深圳赛意法微电子有限公司负债情况图

图表69 深圳赛意法微电子有限公司负债指标走势图

图表70 深圳赛意法微电子有限公司运营能力指标走势图 单位：次

图表71 深圳赛意法微电子有限公司成长能力指标走势图

图表72 南通富士通微电子股份有限公司主要经济指标

图表 73 南通富士通微电子股份有限公司盈利指标走势图

图表 74 南通富士通微电子股份有限公司偿债指标走势图

图表 75 南通富士通微电子股份有限公司运营指标走势图

图表 76 南通富士通微电子股份有限公司成长指标走势图

图表77 中芯国际集成电路制造（天津）有限公司主要经济指标走势图

图表78 中芯国际集成电路制造（天津）有限公司经营收入走势图

图表79 中芯国际集成电路制造（天津）有限公司盈利指标走势图

图表80 中芯国际集成电路制造（天津）有限公司负债情况图

图表81 中芯国际集成电路制造（天津）有限公司负债指标走势图

图表82 中芯国际集成电路制造（天津）有限公司运营能力指标走势图 单位：次

图表83 中芯国际集成电路制造（天津）有限公司成长能力指标走势图

图表84 英特尔产品（成都）有限公司主要经济指标走势图

图表85 英特尔产品（成都）有限公司经营收入走势图

图表86 英特尔产品（成都）有限公司盈利指标走势图

图表87 英特尔产品（成都）有限公司负债情况图

- 图表88 英特尔产品（成都）有限公司负债指标走势图
- 图表89 英特尔产品（成都）有限公司运营能力指标走势图 单位：次
- 图表90 英特尔产品（成都）有限公司成长能力指标走势图
- 图表91 无锡菱光科技有限公司主要经济指标走势图
- 图表92 无锡菱光科技有限公司经营收入走势图
- 图表93 无锡菱光科技有限公司盈利指标走势图
- 图表94 无锡菱光科技有限公司负债情况图
- 图表95 无锡菱光科技有限公司负债指标走势图
- 图表96 无锡菱光科技有限公司运营能力指标走势图 单位：次
- 图表97 无锡菱光科技有限公司成长能力指标走势图
- 图表98 恒宝股份有限公司主要经济指标
- 图表 99 恒宝股份有限公司盈利指标走势图
- 图表 100 恒宝股份有限公司偿债指标走势图
- 图表 101 恒宝股份有限公司运营指标走势图
- 图表 102 恒宝股份有限公司成长指标走势图
- 图表103 南京汉德森科技股份有限公司主要经济指标走势图
- 图表104 南京汉德森科技股份有限公司经营收入走势图
- 图表105 南京汉德森科技股份有限公司盈利指标走势图
- 图表106 南京汉德森科技股份有限公司负债情况图
- 图表107 南京汉德森科技股份有限公司负债指标走势图
- 图表108 南京汉德森科技股份有限公司运营能力指标走势图 单位：次
- 图表109 南京汉德森科技股份有限公司成长能力指标走势图
- 图表110 深圳市比亚迪微电子股份有限公司主要经济指标走势图
- 图表111 深圳市比亚迪微电子股份有限公司经营收入走势图
- 图表112 深圳市比亚迪微电子股份有限公司盈利指标走势图
- 图表113 深圳市比亚迪微电子股份有限公司负债情况图
- 图表114 深圳市比亚迪微电子股份有限公司负债指标走势图
- 图表115 深圳市比亚迪微电子股份有限公司运营能力指标走势图 单位：次
- 图表116 深圳市比亚迪微电子股份有限公司成长能力指标走势图
- 图表117 常州市欧密格电子科技有限公司主要经济指标走势图
- 图表118 常州市欧密格电子科技有限公司经营收入走势图
- 图表119 常州市欧密格电子科技有限公司盈利指标走势图

- 图表120 常州市欧密格电子科技有限公司负债情况图
- 图表121 常州市欧密格电子科技有限公司负债指标走势图
- 图表122 常州市欧密格电子科技有限公司运营能力指标走势图 单位：次
- 图表123 常州市欧密格电子科技有限公司成长能力指标走势图
- 图表124 安靠封装测试（上海）有限公司主要经济指标走势图
- 图表125 安靠封装测试（上海）有限公司经营收入走势图
- 图表126 安靠封装测试（上海）有限公司盈利指标走势图
- 图表127 安靠封装测试（上海）有限公司负债情况图
- 图表128 安靠封装测试（上海）有限公司负债指标走势图
- 图表129 安靠封装测试（上海）有限公司运营能力指标走势图 单位：次
- 图表130 安靠封装测试（上海）有限公司成长能力指标走势图
- 图表131 沛顿科技（深圳）有限公司主要经济指标走势图
- 图表132 沛顿科技（深圳）有限公司经营收入走势图
- 图表133 沛顿科技（深圳）有限公司盈利指标走势图
- 图表134 沛顿科技（深圳）有限公司负债情况图
- 图表135 沛顿科技（深圳）有限公司负债指标走势图
- 图表136 沛顿科技（深圳）有限公司运营能力指标走势图 单位：次
- 图表137 沛顿科技（深圳）有限公司成长能力指标走势图
- 图表138 淄博凯胜电子技术有限公司主要经济指标走势图
- 图表139 淄博凯胜电子技术有限公司经营收入走势图
- 图表140 淄博凯胜电子技术有限公司盈利指标走势图
- 图表141 淄博凯胜电子技术有限公司负债情况图
- 图表142 淄博凯胜电子技术有限公司负债指标走势图
- 图表143 淄博凯胜电子技术有限公司运营能力指标走势图 单位：次
- 图表144 淄博凯胜电子技术有限公司成长能力指标走势图
- 图表145 河南鼎润科技实业有限公司主要经济指标走势图
- 图表146 河南鼎润科技实业有限公司经营收入走势图
- 图表147 河南鼎润科技实业有限公司盈利指标走势图
- 图表148 河南鼎润科技实业有限公司负债情况图
- 图表149 河南鼎润科技实业有限公司负债指标走势图
- 图表150 河南鼎润科技实业有限公司运营能力指标走势图 单位：次
- 图表151 河南鼎润科技实业有限公司成长能力指标走势图

图表152 主要经济指标走势图
图表153 经营收入走势图
图表154 盈利指标走势图
图表155 负债情况图
图表156 负债指标走势图
图表157 汉高华威电子有限公司主要经济指标走势图
图表158 汉高华威电子有限公司经营收入走势图
图表159 汉高华威电子有限公司盈利指标走势图
图表160 汉高华威电子有限公司负债情况图
图表161 汉高华威电子有限公司负债指标走势图
图表162 汉高华威电子有限公司运营能力指标走势图 单位：次
图表163 汉高华威电子有限公司成长能力指标走势图
图表164 厦门惠利泰化工有限公司主要经济指标走势图
图表165 厦门惠利泰化工有限公司经营收入走势图
图表166 厦门惠利泰化工有限公司盈利指标走势图
图表167 厦门惠利泰化工有限公司负债情况图
图表168 厦门惠利泰化工有限公司负债指标走势图
图表169 厦门惠利泰化工有限公司运营能力指标走势图 单位：次
图表170 厦门惠利泰化工有限公司成长能力指标走势图
图表171 福建易而美光电材料有限公司主要经济指标走势图
图表172 福建易而美光电材料有限公司经营收入走势图
图表173 福建易而美光电材料有限公司盈利指标走势图
图表174 福建易而美光电材料有限公司负债情况图
图表175 福建易而美光电材料有限公司负债指标走势图
图表176 无锡创达电子有限公司主要经济指标走势图
图表177 无锡创达电子有限公司经营收入走势图
图表178 无锡创达电子有限公司盈利指标走势图
图表179 无锡创达电子有限公司负债情况图
图表180 无锡创达电子有限公司负债指标走势图
图表181 无锡创达电子有限公司运营能力指标走势图 单位：次
图表182 无锡创达电子有限公司成长能力指标走势图
图表183 鼎贞（厦门）系统集成有限公司主要经济指标走势图

- 图表184 鼎贞（厦门）系统集成有限公司经营收入走势图
- 图表185 鼎贞（厦门）系统集成有限公司盈利指标走势图
- 图表186 鼎贞（厦门）系统集成有限公司负债情况图
- 图表187 鼎贞（厦门）系统集成有限公司负债指标走势图
- 图表188 无锡市江达精细化工有限公司主要经济指标走势图
- 图表189 无锡市江达精细化工有限公司经营收入走势图
- 图表190 无锡市江达精细化工有限公司盈利指标走势图
- 图表191 无锡市江达精细化工有限公司负债情况图
- 图表192 无锡市江达精细化工有限公司负债指标走势图
- 图表193 陕西华电材料总公司主要经济指标走势图
- 图表194 陕西华电材料总公司经营收入走势图
- 图表195 陕西华电材料总公司盈利指标走势图
- 图表196 陕西华电材料总公司负债情况图
- 图表197 陕西华电材料总公司负债指标走势图
- 图表198 陕西华电材料总公司运营能力指标走势图 单位：次
- 图表199 陕西华电材料总公司成长能力指标走势图
- 图表200 无锡嘉联电子材料有限公司主要经济指标走势图
- 图表201 无锡嘉联电子材料有限公司经营收入走势图
- 图表202 无锡嘉联电子材料有限公司盈利指标走势图
- 图表203 无锡嘉联电子材料有限公司负债情况图
- 图表204 无锡嘉联电子材料有限公司负债指标走势图
- 图表 205 2011-2015年中国IC封装市场规模预测
- 图表 206 2011-2015年中国IC封装市场盈利预测

通过《2011-2015年中国IC先进封装产业链发展市场分析与投资前景预测报告》，生产企业及投资机构将充分了解产品市场、原材料供应、销售方式、市场供需、有效客户、潜在客户等详实信息，为研究竞争对手的市场定位，产品特征、产品定价、营销模式、销售网络和企业的发展提供了科学决策依据。

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/188795.html>

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（www.icandata.com）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业提供专业投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;
数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;
服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;
良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。